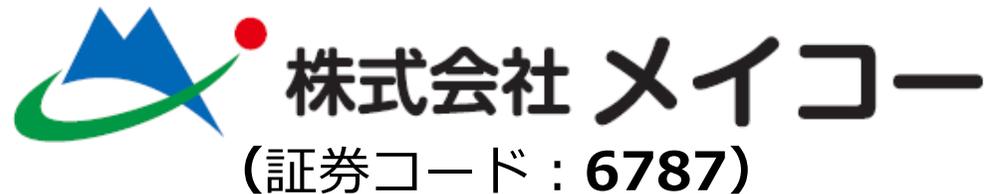


2025年3月期第1四半期 決算補足説明資料

2024年8月6日



注意事項

本資料には過去の事実以外に今後の業績予想等・戦略が含まれますが、本資料は金融商品取引法の開示情報ではありません。

これらの予想は過去の事実ではなく、現時点で当社が把握できる情報で判断した想定及び所見で作成したものです。

特に電子回路基板業界では原材料価格の変化、多様な顧客市場動向、技術動向の変化、為替変化、税制・諸制度の変更、自然災害、国際紛争、その他、新型コロナウイルス等の感染症を含め、様々なリスク・不確実性があり、実際の実績は予想と異なることがあります。

2025年3月期第1四半期 業績

(単位：億円)

	2024年3月期	2025年3月期	前年同期比	
	Q1実績	Q1実績	増減額	増減率
売上高	416	470	54	13.0%
営業利益	9 2.2%	33 7.0%	24	260.0%
経常利益	29 7.0%	44 9.4%	15	50.3%
当期純利益	23 5.3%	31 6.5%	8	35.0%
期中平均為替レート (JPY/USD)	139.63	158.24		

2025年3月期第1四半期 商品別実績

(単位：億円)

	2024年3月期Q1実績		2025年3月期Q1実績		前年同期比	
	売上高	営業利益	売上高	営業利益	売上高 増減率	営業利益
		営業利益率		営業利益率		増減率
車載	211	13 6.2%	230	18 7.8%	19 9.0%	5 38.5%
スマートフォン タブレット	49	-8 -16.3%	61	8 13.1%	12 24.5%	16 -
半導体パッケージ	1	-2 -200.0%	4	-4 -100.0%	3 300.0%	-2 -
SSD IoTモジュール	17	0 0.0%	30	3 10.0%	13 76.5%	3 -
衛星通信			14	2 10.7%	14	2 -
AI家電 アミューズメント 産機他	50	2 4.0%	50	3 6.0%	0 0.0%	1 50.0%
EMS 電子機器開発製造	88	4 4.5%	81	3 3.7%	-7 -8.0%	-1 -25.0%
合計	416	9 2.2%	470	33 7.0%	54 13.0%	24 260.0%

仕様別売上高シェア

(単位：億円)

■ 多層貫通基板 ■ ビルドアップ基板 ■ リジットフレキ/フレキ基板 ■ 放熱/大電流/他基板 ■ 半導体パッケージ基板 ■ その他 ■ EMS/電子機器開発製造

